

未來計劃及[編纂]

未來計劃

請參閱「業務－我們的發展戰略」，了解有關我們未來計劃的詳細說明。

[編纂]

我們估計，假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述最高[編纂]），我們將自[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]港元（經扣除我們就[編纂]已付或應付的[編纂]及估計開支）。

根據我們的戰略，我們擬就以下目的並按下文所載金額應用[編纂][編纂]淨額：

- 約[編纂]%的[編纂]淨額或[編纂]港元將用於增強我們的研發能力，開發新產品系列及提升產品性能，包括高性能MCU、多協議通信芯片、專業市場芯片、車規級芯片等。

我們的目標是開發我們尚未進入或尚未具備產品化能力的新產品類別或平台，並擴大新產品線及進入新市場。例如，我們計劃開發高性能MCU芯片（如基於M85內核或集成NPU、突破現有M0/M4/M7內核性能限制的新一代MCU），並探索多協議通信芯片等新產品方向。上述為建立全新技術能力及實現產品性能或適用標準代際飛躍所作的承諾，就是我們對新產品「從0到1」的戰略投資。更具體而言：

- (1) 約[編纂]%的[編纂]淨額或[編纂]港元將用於高性能MCU芯片的開發，可應用於機器人、工業伺服、PLC、HMI等場景。該等產品預期將具有更高的主頻，內置專有向量計算單元，支持機器人等邊緣AI計算應用。我們亦擬積極開發具備集成算力、控制及接口功能的電機控制MCU，用於工業控制用途。我們計劃將該等[編纂]用於招聘研發人員及支付未來五年有關研發活動的其他相關開支，包括設備採購費、軟件採購費、測試費、產品認證費及流片費。

未來計劃及[編纂]

- (2) 約[編纂]%的[編纂]淨額或[編纂]港元將用於多協議通信芯片的開發，可應用於工業控制、PLC等應用場景。該等產品預期將可在統一的多協議通信平台下兼容包括EtherCAT、PROFINET及EtherNet/IP在內的主流國際協議，從而具備更佳的通信能力以支持工業用途。我們計劃將該等[編纂]用於招聘研發人員及支付未來五年有關研發活動的其他相關開支，包括設備採購費、軟件採購費、測試費及流片費。
- (3) 約[編纂]%的[編纂]淨額或[編纂]港元將用於專業市場芯片的開發，為智能終端、工業4.0及車聯網提供具有安全性、高效的連接基石，並可提供智能手機與平板、可穿戴設備等消費級解決方案、智能製造與能源管理等工業級解決方案；以及車聯網、AIoT等新興場景的解決方案。該等產品預期將具備更佳的安全功能，特別是預期將集成支持商用及國際雙重加密算法引擎的HSM模塊，以支持智能座艙及自動駕駛等汽車應用，並促進車載信息安全生態系統的發展。我們計劃將該等[編纂]用於招聘研發人員及支付未來五年有關研發活動的其他相關開支，包括軟件採購費、測試費、產品認證費及流片費。
- (4) 約[編纂]%的[編纂]淨額或[編纂]港元將用於車規級芯片的開發，可應用於數字鑰匙與無感交互、協同感知與自動駕駛以及車雲通信等汽車場景。我們計劃將該等[編纂]用於招聘研發人員及支付未來五年有關研發活動的其他相關開支，包括軟件採購費、測試費、產品認證費及流片費。

以下是我們預計的新產品開發時間表：

研究項目	預計 啟動日期	預計 流片日期	預計樣品 測試日期	預計開始 銷售日期	預計 量產日期
高性能MCU 1.	2026年	2027年	2027年	2027年	2028年
高性能MCU 2.	2027年	2028年	2028年	2029年	2029年

未來計劃及[編纂]

研究項目	預計 啟動日期	預計 流片日期	預計樣品 測試日期	預計開始 銷售日期	預計 量產日期
多協議通信芯片	2027年	2027年	2028年	2028年	2029年
專用市場芯片..	2027年	2027年	2028年	2028年	2029年
車規級芯片....	2028年	2029年	2029年	2030年	2031年

- 約[編纂]%的[編纂]淨額或[編纂]港元將用於升級我們的現有產品組合。

我們計劃將該等[編纂]用於招聘研發人員及支付未來五年有關研發活動的其他相關開支，包括軟件採購費、測試費及流片費。我們的目標是對現有量產及成熟的產品進行迭代和優化，從而提升市場競爭力及全生命週期價值。該等活動著重在現有技術框架內持續改進。對於量產超過一定年限(如5年)的產品，可通過優化設計、更新製造流程、或增強周邊功能進行改進，以解決客戶痛點，適度提升性能或降低成本。此類開發升級不會改變產品的內核架構或基本市場定位，是一項「從存在到卓越」的戰略投資，旨在鞏固公司在現有市場的地位。例如，在不改變其內核架構的情況下，將現有MCU芯片內存從512KB升級到1MB以滿足新的客戶需求。具體而言，我們擬改進現有產品和IP模塊(例如ADC、DAC、HSI等模擬IP模塊)，以降低功耗、優化後端製程並減少IP模塊的尺寸。

以下是我們預計的現有產品升級時間表：

研究項目	預計 啟動日期	預計 流片日期	預計樣品 測試日期	預計開始 銷售日期	預計 量產日期
現有MCU產品1....	2026年	2026年	2027年	2027年	2027年
現有MCU產品2....	2027年	2027年	2028年	2028年	2028年
現有MCU產品3....	2028年	2028年	2029年	2029年	2029年
現有MCU產品4....	2029年	2029年	2030年	2030年	2030年
現有MCU產品5....	2030年	2030年	2031年	2031年	2031年

未來計劃及[編纂]

- 約[編纂]%的[編纂]淨額或[編纂]港元將用於開展戰略投資及收購。

我們尋求獲得業務與我們的芯片業務具有一定互補或協同效應的公司的少數權益或將其收購。我們計劃投資或收購中國及其他海外國家或地區半導體產業鏈公司，包括從事混合信號、模擬、信號鏈、電源管理集成電路、存儲器、微處理器、無線通信等領域的公司，以及其他符合半導體產業發展趨勢的優質目標，以進一步提升我們的技術能力和經營效率。雖然過去數年我們主要將資源集中於內部研發，以開發我們的MCU技術平台並鞏固核心專業技術，但由於計劃進行擴張，我們擬優先收購專注於在功能上配套主控芯片(如MCU)的電源管理IC、驅動芯片、時鐘芯片、接口芯片等周邊產品的目標公司，以建立更完整的產品生態系統。在技術架構上，主控芯片作為系統的核心處理單元，其高效穩定的運行依賴關鍵支持單元。電源管理IC負責系統供電與功耗管理；驅動芯片實現控制信號的功率轉換；時鐘芯片提供精確的計時參考；接口芯片擴展系統的外部通信能力。該等芯片雖然對系統穩定性及可靠性至關重要，但其規格及功能主要取決於主控芯片的技術特性，因而形成產品邏輯中自然的互補從屬關係。通過收購這些周邊產品公司，我們致力於發展成為提供高度協同芯片組合的綜合系統解決方案提供商，而不僅只為單一元件供應商，我們認為這將增強我們的以下核心競爭優勢：(i)提供更具競爭力的產品組合以抵禦價格競爭，這是由於競爭將從單個芯片的價格轉向完整解決方案的整體價值(包括系統可靠性、開發便利性及供應鏈效率)。客戶為降低系統設計和採購風險並加快產品上市時間而願意付費購買整套方案可有效降低對個別產品的價格敏感度；(ii)構建完整的產品生態系統以提升客戶黏性，這是由於客戶在產品設計中採用我們整套芯片後，其硬件設計、軟件驅動及測試流程將深度融合，轉換成本隨之增加；及(iii)在汽車電子、工業控制及物聯網等高價值應用領域建立差異化的競爭優勢，這是由於我們提供整套產品及相關服務組合將可顯著提高客戶產品的開發效率及最終性能表現。此舉可建立以「賦能客戶成功」為核心且難以簡單複製的差異化競爭優勢。請參閱「業務－我們的發展戰略－吸納全球頂尖人才，有選擇地探索收購機會」。

未來計劃及[編纂]

截至最後實際可行日期，我們尚未確定具體的潛在投資或收購目標，但我們擬收購符合以下標準的目標公司：(i)年收入在人民幣50百萬元至人民幣300百萬元之間；(ii)在其專業領域市場份額在3%至10%之間；(iii)產品毛利率在35%至50%之間；(iv)擁有至少2至3家主要客戶，且單一客戶的收入佔比不超過總收入的40%；或(v)擁有經市場驗證的核心技術能力及與我們策略產生協同效應的關鍵知識產權。根據灼識諮詢的資料，可能有超過500個潛在收購目標符合該等標準。我們預計於未來三年內完成有關收購。通過戰略投資或收購，我們將進一步增強前瞻性的技術佈局，擴大產品組合，並加速向更多下游應用市場的滲透。

- 約[編纂]%的[編纂]淨額或[編纂]港元將用於償還部分尚未償還銀行貸款。

我們擬償還部分年利率為4.20%的銀行貸款（將於2027年及2035年到期）。該等銀行貸款用作營運資金用途。我們認為，提早償還該等銀行貸款將有效降低我們未來的融資成本。我們擬於一年內償還該等銀行貸款。

- 約[編纂]%的[編纂]淨額或[編纂]港元將用於營運資金及其他一般公司用途。

倘我們的[編纂]不足為上述用途提供資金，我們擬透過多種方式（包括經營所得現金、銀行貸款和其他借款）為該餘額提供資金。

倘由於政府政策變化將致使我們的任何計劃不可行或發生不可抗力事件等原因，我們計劃的任何部分未能按計劃進行，我們的董事將仔細評估有關情況並可能重新分配[編纂][編纂]淨額。倘上述擬定[編纂]有任何重大變化，我們將適時刊發公告。

倘[編纂][編纂]淨額未即時用作上述用途，在相關法律及法規允許的範圍內，我們擬將[編纂]存入持牌商業銀行及／或其他認可金融機構（定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區的適用法律及法規）的短期計息賬戶。